

<<电子产品结构工艺>>

图书基本信息

书名：<<电子产品结构工艺>>

13位ISBN编号：9787505372320

10位ISBN编号：7505372327

出版时间：2002-6

出版时间：电子工业出版社

作者：任德齐 编

页数：144

字数：249000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子产品结构工艺>>

内容概要

本书是根据教育部《电子产品结构工艺》教学大纲编写的，内容包括：电子产品结构工艺基础、电子产品的防护、印制电路板、电子产品装配工艺、表面安装及微组装技术、电子设备调试工艺、电子产品技术文件、电子产品结构微型化。

本书适于作为中等职业学校电子技术类教材使用。

<<电子产品结构工艺>>

书籍目录

第1章 电子产品结构工艺基础? 1.1 概述? 1.2 对电子产品的基本要求? 1.3 电子产品的可靠性? 本章 小结? 习题1?第2章 电子产品的防护? 2.1 气候因素的防护? 2.2 电子产品的散热及防护? 2.3 机械因素的隔离? 2.4电磁干扰的屏蔽? 本章 小结? 习题2? 实训项目典型电子产品解剖?第3章 印制电路板? 3.1 概述? 3.2 印制电路板的设计基础? 3.3 印制电路板的制造与检验? 3.4印制电路CAD简介? 3.5印制电路的新发展? 本章 小结? 习题3? 实训项目印制电路板设计第4章 电子产品装配工艺? 4.1 装配工艺技术基础? 4.2 印制电路板的组装? 4.3 整机组装? 本章 小结? 习题4? 实训项目印制电路板组装第5章 表面安装及微组装技术? 5.1 概述? 5.2 表面安装元器件? 5.3 表面安装技术? 5.4微组装技术? 本章 小结? 习题5? 实训项目参观表面安装生产现场第6章 电子产品调试工艺? 6.1 概述? 6.2 调试工艺技术? 6.3 整机检测与维修? 本章 小结? 习题6? 实训项目整机性能测试第7章 电子产品技术文件? 7.1 概述? 7.2 设计文件? 7.3 工艺文件? 7.4技术文件自动处理系统简介? 本章 小结? 习题7? 实训项目技术文件的绘制第8章 电子产品结构微型化? 8.1 电子产品结构系统? 8.2 电子产品结构微型化? 8.3 人机系统简介? 本章 小结? 习题8参考文献

<<电子产品结构工艺>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>